

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技                      股票代码：688019                      编号：2025-013

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访                              <input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会                           <input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 （请文字说明其他活动内容）</div>                        |
| 参与单位名称                | 招商基金、中信证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间                    | 2025 年 9 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地点                    | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 公司<br>接待人员姓名          | 董事、副总经理、董事会秘书 杨逊<br>证券事务主管 冯倩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资者关系<br>活动<br>主要内容介绍 | <p>一、公司介绍：</p> <p>介绍公司经营业务情况及未来发展规划等。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p><b>Q：功能性湿电子化学品哪些产品带动营收增长，未来的趋势如何展望？</b></p> <p>A：公司持续丰富功能性湿电子化学品产品系列的开发和导入，积极在先进技术节点应用领域布局，目前已涵盖刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列，多款产品在多家客户上量及供应稳定。2025 年上半年，在刻蚀后清洗液方面，先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化进展顺利，快速上量，并扩大海外市场；在抛光后清洗液方面，先进制程碱性抛光后清洗液进展顺利，快速上量，持续增加市场份额。</p> <p>公司对于功能性湿电子化学品的定位是技术和市场的领导者，致力于攻克领先技术节点并提供相应的产品和解决方案，公司将持续拓展产品线布局，逐步提升功能性湿电子化学品的市场份额，成为国内市场的主流供应商。</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>Q：电镀液及添加剂的进展情况？</b></p> <p>A：关于电镀液及添加剂产品，不同于抛光液、清洗液等耗材，其会留存于晶圆内部，直接影响芯片质量，因此客户在供应商选择上更为审慎，验证及放量节奏慢于抛光液、清洗液等耗材类产品。公司正式启动电镀液及添加剂研发以来，仅用几年的时间便完成核心技术突破与客户认可，当前产品已覆盖多种电镀液及添加剂品类。报告期内，电镀液本地化供应进展顺利，持续上量；集成电路大马士革电镀液及添加剂、先进封装锡银电镀液及添加剂、硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行。</p> <p><b>Q：公司毛利率波动的原因和未来展望？</b></p> <p>A：公司三大产品平台项下拥有众多不同产品，产品品类、上量节奏、市场策略等差异均会影响公司的综合毛利率。报告期内，公司毛利率波动主要是产品线内产品结构变化，规模效应及市场策略调整等原因导致的。未来展望上，公司毛利率将以“长期稳健”为核心导向，会将综合毛利率控制在健康区间内，以支撑后续研发投入与全球化扩张。</p> <p><b>Q：公司出海计划和进展如何？</b></p> <p>A：公司始终以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，目前海外拓展主要聚焦中国台湾地区和东南亚，日本、韩国等市场为中期关注的区域。公司以循序渐进，按需进展的策略，稳健、务实地开展海外布局。截至目前，公司积极拓展中国台湾地区的市场，海外团队在当地实验环境搭建、团队成长以及与客户的技术合作项目、产品验证进程均取得阶段性进展，为后续海外市场渗透奠定基础。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 日期           | 2025 年 9 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |